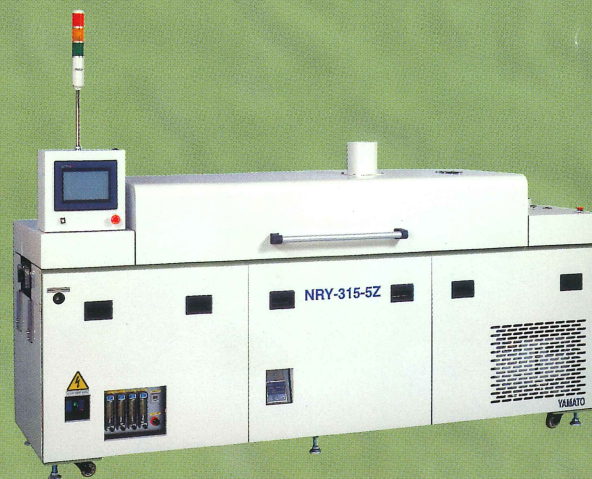


鉛フリー半田対応コンパクトサイズN₂リフローシリーズ

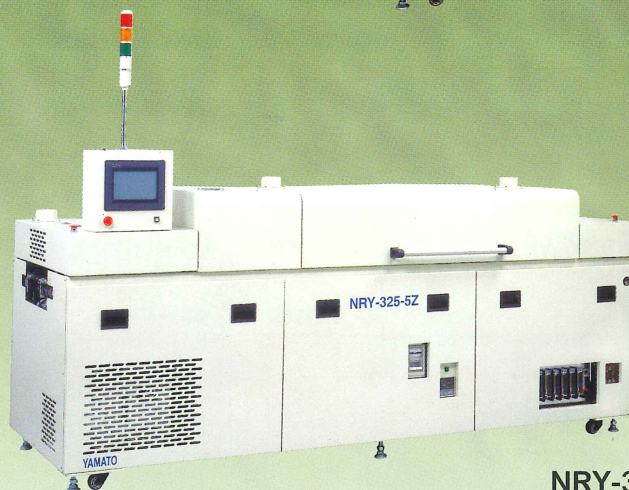
COMPACT N₂ REFLOW SERIES FOR LEAD FREE SOLDER



NRY-520S-5Z



NRY-315-5Z



NRY-325-5Z

主な特長

1. 温度精度(面内温度分布)の向上と低酸素濃度下での半田付けを目的とした電子デバイスメーカー向けリフロー装置!
2. クリーンルーム対応・コンパクト設計・省エネ化を追求!
3. 小型ながら5ゾーンの加熱ゾーンを装備! 多彩な温度プロファイルを設定できます。
4. BGAやCSPの半田ボール形成用リフローとしてもご使用できます。
5. ローダー/アンローダーや中間バッファーを含む周辺装置も取り揃えております。
6. 温度プロファイルモニターや酸素濃度自動コントロール、窒素発生器などのオプション群もさらに充実。

Major features

1. The reflow equipment for electronic device manufacturers featuring its improvement in temperature accuracy (in-plane temperature distribution) and for soldering in the atmosphere in low oxygen density!
2. Pursuing its ideal application in clean rooms, compact design and energy-saving performance.
3. Small in dimensions and yet equipped with heating zones as many as five zones. It allows you to set a variety of temperature profiles.
4. Designed for additional use for reflow for forming of soldering balls such as BGA, CSP and many others.
5. Available are a large assortment of peripheral equipment including loaders, unloaders and intermediate buffers.
6. Optional equipment available from Yamato Works includes temperature profile monitors, automatic oxygen density controls, N₂ generators and many others.

YAMATO WORKS CO.,LTD.